

股票简称：鸿远电子

股票代码：603267



北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2026 年度

以简易程序向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年八月

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“鸿远电子”或“公司”）是在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 30,000.00 万元（含本数）。

本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的 20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额	占募集资金比例
1	多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目	14,152.80	12,371.15	41.24%
2	微纳系统封装管壳产业化项目	15,616.75	14,089.43	46.96%
3	补充流动资金	3,539.42	3,539.42	11.80%
合计		33,308.97	30,000.00	100.00%

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

公司属于具有轻资产、高研发投入特点的企业，且本次募投项目非资本性支出未超过募集资金总额 30%，主要用于补充流动资金和与主营业务相关的研发投入，因此，本次发行符合《注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号（2026 修正）》

《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号——轻资产、高研发投入认定标准（2026 年修订）》等相关法律法规的规定，具有可行性。

二、项目方案概述及必要性、可行性分析

（一）多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目

1、项目基本情况

为顺应 MLCC 行业微型化、高容量、高压化的技术发展趋势，提升公司产品在多应用领域的自主供给能力，本项目拟在现有生产基地内，通过改造部分厂房、购置先进生产与检测设备、升级软件系统，建设智能化产线，对微小型/高容量、高压安规瓷介电容器及可调电容器等产品进行产线技术升级改造和规模化量产。项目实施旨在系统性增强公司 MLCC 产品的技术竞争力，推动产品向汽车电子、工业控制、服务器、高端医疗等民用高端领域拓展，优化公司整体业务结构。

2、项目实施的必要性及经营前景

（1）提升高端 MLCC 产品供给能力与微小型产品自动化制造水平

当前，全球 MLCC 市场呈现“高集中度、高壁垒”的竞争格局，日韩系厂商合计占据全球过半市场份额，高端产能高度集中于村田、三星电机等少数巨头手中。尽管国内 MLCC 企业在消费电子领域已实现规模化应用，但在高容量、高耐压等部分中高端规格产品上的自主供给能力仍存结构性不足，部分高端 MLCC 仍依赖进口，该领域供给能力的提升已成为我国电子信息产业补链强链、提升供应链韧性的关键环节之一。

本项目拟通过引进高精度叠层机、切割机及测试机等核心自动化设备，配套建设智能化生产车间并优化全流程制造执行系统，从设备精度、工艺控制与数据追溯三个维度同步提升制造能力。项目实施有助于提高公司高端 MLCC 的额定产能与批次一致性水平，为汽车电子、工业控制、服务器、高端医疗等民用高端领域持续提供符合严格可靠性标准的高性能产品，有效提升在上述领域的自主供给水平；推动微小型 MLCC 实现高精度自动化规模制造，通过全流程智能管控保证产品一致性 & 良率，在此类规格标准化、市场竞争较充分的产品领域，逐步构筑以成本与质量并重的复合竞争优势。

（2）促进公司产品向多领域应用拓展，优化业务结构

公司长期深耕高可靠领域，积累了深厚的技术底蕴和客户资源，但该市场总体容量存在一定的阶段性特征，因此公司拟持续深度挖掘 MLCC、可调电容产品在高端民用市场的多元价值潜力，开辟新的发展空间。汽车电子、工业控制、服务器、高端医疗等领域对高性能 MLCC 及精密可调电容器的需求大幅攀升，整体呈现出高容量、高压安规、耐高温、可靠性及小型化等共性趋势，产品技术门槛与附加值双高。具体而言，新能源汽车的渗透加速使得三电系统、智能驾驶模块对车规级 MLCC 的用量与可靠性要求急剧提升，单车 MLCC 用量正从数千颗向万颗级别演进；工业自动化与智能制造推动伺服、变频等设备对高压、低损耗 MLCC 的需求持续增长；服务器及数据中心的高功耗芯片则对高压大容量、低 ESL 产品形成强劲需求；高端医疗影像与监测设备、商业航天卫星载荷等对小型化、高稳定性元件同样存在迫切配套需求，且精密可调电容器在射频调谐与阻抗匹配场景下亦面临高精度、高稳定性的升级要求。

上述增量市场为公司现有技术能力的延伸提供了广阔空间。本项目将依托公司在高可靠领域积累的共性技术平台，将材料、工艺及可靠性管控等方面的经验拓展至上述领域，推动产品体系向“高可靠+民用高端”双轮驱动的格局发展，逐步构建更为均衡的收入结构，增强公司整体经营的稳健性和抗周期能力。

（3）顺应下游技术迭代趋势，强化产品技术竞争力

MLCC 及可调电容器的下游应用领域正经历快速技术迭代，对产品综合性能提出系统性挑战。在新能源汽车领域，整车高压平台向 800V 及以上升级，对

安规 MLCC 的耐压等级、高温稳定性及长期可靠性提出更高标准，车规级产品需通过 AEC-Q200 认证并在严苛工况下保持极低缺陷率。在服务器领域，高性能计算芯片功耗密度持续上升，要求更高容量、更小尺寸的 MLCC 以实现低等效串联电感和快速瞬态响应，满足电源完整性需求。在工业控制领域，随着智能制造与工业自动化的深入推进，伺服驱动、变频器、工业电源等核心设备要求 MLCC 具备宽温度范围、长寿命和高稳定性，以适应复杂恶劣的工业环境。在高端医疗领域，医疗影像及精密监测设备向高精度、微型化发展，对可靠性、微型化 MLCC 提出严格要求。低轨卫星星座组网加速推进，运载火箭、卫星平台及空间站等场景对 MLCC 的抗辐射、长寿命、可靠性等提出了严苛要求。同时，可调电容器作为射频、微波等设备中的精密调谐元件，呈现出高精度、低损耗、高耐压、小型化、高质量的发展态势，在通信、医疗、工业及航天等领域，随着设备精度和识别能力不断提升，对大功率精密调谐与国产化替代的需求愈发迫切。上述趋势要求公司具备从材料配方、结构设计到精密制造的系统性技术能力，并能够跟随应用需求持续迭代。

本项目的实施，是公司顺应行业技术发展趋势、提升自身技术能力的重要举措。依托本项目配置的研发平台与试验条件，公司将在以下方向进行重点技术攻关：一是突破高介电常数纳米级介质浆料的稳定制备与超薄流延技术，开发更高容量密度、更小尺寸的产品，满足高压大容量场景对体积与性能的双重要求；二是针对高压安规产品开展结构与失效模式研究，开发耐高温、抗冲击的端头与内电极，保障车规级和工业级产品在极端工况下的安全可靠；三是探索低损耗共烧陶瓷材料与低电阻电极工艺，并结合结构优化降低高频工况下的 ESL 与 ESR，为服务器、通信射频等领域提供低损耗产品方案；四是推进微型可调电容器的精密装配与反馈控制技术研究，提升器件在宽频段内的调谐精度与长期稳定性，增强公司在高端射频调谐元件方面的配套能力；五是建设多应力可靠性加速测试与失效分析平台，建立覆盖高温、高压、高湿、振动等条件的寿命评估模型与设计规范，形成面向多领域可靠性产品的自主评价体系。上述技术方向的突破，将推动公司由目前以高可靠需求为主的技术形态，逐步发展为具备多领域、多品种、梯度化新品开发能力的综合平台，有助于缩小与国际先进水平的差距，增强公司在更广阔市场中的持续竞争能力。

3、项目实施的可行性分析

(1) 公司已具备项目实施所需的技术基础和工艺平台

公司长期深耕瓷介电容器领域，已建立起从陶瓷介质材料开发、产品结构设计、制造工艺优化到成品可靠性验证、产品应用仿真的完整技术体系，具备从需求分析到样品交付的全链条自主实现能力。在材料端，公司具备以纳米钛酸钡为基材的配方粉开发和工艺适配优化能力，能够满足小型化产品对材料均匀性的较高要求；在工艺端，公司在薄膜介质成型、高精度内电极制备、多层精密堆叠、还原气氛烧结及端电极致密化等关键制程环节积累了丰富的量产经验，形成了覆盖小型化、高电压、高容化产品的精密加工能力。在可调电容器方面，公司掌握了高频低损耗介质材料选用、微米级精密加工、高频焊接及粘结密封等关键技术，并完成产品送样测试及部分试制规格型号产品的销售。公司具备实施本项目的扎实技术基础，项目实施风险相对可控。

(2) 公司具备项目实施的质量管理基础和运营体系

对于面向汽车电子、工业控制等领域的 MLCC 产品，客户在批量供货一致性、质量追溯能力和交货稳定性方面有较高的要求。公司在现有业务运营中已建立了符合 IATF16949、ISO9001 等标准的质量管理体系，并通过了相关认证审核，为车规级和工业级产品的生产运营提供了体系框架。在过程管控方面，公司关键工序的工艺参数实现了过程实时采集及自动判读，全线产品生产过程能力管控标准满足车规级元器件行业要求。在检测手段方面，公司搭建了覆盖原材料入厂、生产制程、成品检测、可靠性验证的全链条闭环质控体系，原材料端实施全批次关键参数复检，从源头锁定原料性能一致性；制程端搭载在线 AOI 视觉检测、激光测厚实时监测、X 射线内部断层扫描及声学显微检测等设备，实现制程异常实时预警与不良品自动剔除；成品端执行 100% 全电气参数检测，包含容量、损耗、绝缘电阻、耐压全项筛查，确保出厂产品性能达标。上述质量管理基础和运营体系，为项目顺利实施和产品可靠交付提供了较为完整的体系保障与过程控制条件。

(3) 项目产品具备可预期的市场空间和客户导入基础

本项目对应的微小型、高容量、高压安规 MLCC 以及可调电容器产品，主

要面向新能源汽车、工业控制、服务器、高端医疗等增长确定性较好的领域。上述领域对元器件的认证周期、供货稳定性和批次一致性普遍有较高要求，一旦完成导入，客户黏性相对较强，有利于形成较为稳固的供应关系。下游市场总体处于增长通道，为项目产能消化提供了较为有利的宏观环境。在客户导入方面，公司已在部分目标领域开展了前期布局，并在部分头部客户中完成产品送样、试供或小批量供货，技术与品质获得初步验证。公司上述市场前期工作的有效推进，为项目投产后较快实现订单转化创造了有利条件。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为鸿远苏州，拟投资总额 14,152.80 万元，其中拟使用募集资金投入 12,371.15 万元。本项目投资概算列示如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	总投资额	拟使用募集资金	募集资金投入占比
1	工程建设费用	9,371.15	9,371.15	75.75%
1.1	建筑工程	482.50	482.50	3.90%
1.2	设备购置及安装	8,888.65	8,888.65	71.85%
2	研发费用	3,797.11	3,000.00	24.25%
3	预备费	281.13		
4	铺底流动资金	703.41		
合计		14,152.80	12,371.15	100.00%

5、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目建设内容主要包括场地装修、设备购置及安装、人员招聘与培训、研发课题开展及试运行，整体建设期为 2 年。计划实施进度表如下：

阶段/时间	T+1		T+2	
	H1	H2	H1	H2
项目前期准备				
装修装饰设计				
装修施工				
软硬件采购、安装及调试				
人员招聘与培训				
研发课题开展				

阶段/时间	T+1		T+2	
	H1	H2	H1	H2
试运行				

6、项目审批备案情况

本项目建设地点位于江苏省苏州市高新区科技城吕梁山路 186 号，利用公司现有厂房实施。项目已取得苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证项目代码 2607-320505-89-02-834752），环评手续尚在办理中，公司将根据相关法律法规要求，积极推进相关手续的办理，确保项目后续建设的合规性。

7、项目经济效益情况

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入。

（二）微纳系统封装管壳产业化项目

1、项目基本情况

为把握微纳系统封装市场快速增长及国产化的窗口机遇，巩固并提升公司在以 HTCC 技术为核心的微纳系统封装管壳产品技术与市场地位，公司将通过购置先进生产与检测设备、引进专业技术人才，在现有成熟工艺技术体系和业务模式的基础上，系统性地提升微波器件、光传感器、光模块等领域用微纳系统封装管壳的批量化生产能力与研发水平。本项目落地后，将有效扩大公司微纳系统封装管壳产品的供应规模，进一步完善公司电子陶瓷产品矩阵，深化关键技术布局，为公司奠定更加稳固的市场竞争地位。

2、项目实施的必要性及经营前景

（1）顺应市场扩容趋势，把握国产化窗口机遇

随着电子系统向微型化、高密度集成和高可靠性发展，HTCC 陶瓷封装产品以其优异的耐高温、结构强度强、化学稳定性卓越、高气密性等特性，在航空航天、光通信、高端传感器等领域的需求持续增长。根据 QYResearch 数据，全球 HTCC 陶瓷封装市场规模预计到 2032 年将达到 50.40 亿美元，其中 HTCC

封装管壳约占 70.6%。当前全球市场主要由日系厂商主导，如京瓷、NGK 等日系厂商在高端 HTCC 陶瓷粉体、精密管壳成型、高可靠金属化封装领域构筑了长期技术壁垒和渠道优势，提供了全球约 69%的产能。与此同时，国内本土企业由于起步较晚，在产品设计、材料选型/制备、共烧工艺等方面的研发技术储备相对薄弱，具备量产能力的企业较少。叠加地缘政治因素以及全球供应链重塑，我国下游厂商对核心部件国产化、供应链安全稳定的诉求日益强烈，本土优质供应商迎来业务切入机遇。因此，在市场需求旺盛、产业链国产化进程全面加速的背景下，抢占 HTCC 产品市场先机，拓展客户群体，驱动业绩增长成为公司的重要发展战略。

现阶段，公司已在部分头部客户中完成产品送样、试供或小批量供货，技术与品质获得初步验证。本项目的实施有助于公司紧抓市场扩容与国产化的战略窗口期，系统性地升级产线与设备，强化自主创新能力，保障对重点客户在交付连续性、批次一致性与快速响应方面的支撑能力，为我国航空航天、光通信、光传感产业的高质量发展与自主可控提供坚实的产品与技术支撑。

（2）深化核心技术开发与应用，强化核心业务竞争力

微纳系统封装管壳产品领域的竞争核心在于材料配方与精密制造工艺。公司已在陶瓷管壳设计、原材料制备、电路仿真、多层共烧及可靠性验证等环节构建了一体化技术体系。在原材料制备技术，公司已掌握先进的陶瓷原料制备技术，陶瓷材料配方以及金属浆料配方体系，能够为微纳系统封装管壳产品提供高性能、低成本的原材料，能够实现从原料到产品的全流程自主可控；在生产工艺方面，公司能够实现气密性 $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，孔径精度 $\pm 5 \mu\text{m}$ ，并可通过微针和微同轴结构实现 3 层垂直堆叠，微针直径 0.3mm 的精密制造能力。

为持续拉近与国际先进水平的差距并构建前瞻性技术储备，本项目拟集中推动高密度布线、陶瓷共烧等现有材料和工艺的优化以提升产品良率与性能；同时重点布局 3D 堆叠高密度微波 SiP 陶瓷管壳、高导热光通信管壳、大尺寸光传感器外壳等前沿产品与技术的开发。本项目的顺利实施将直接增强公司面向多元化高端市场提供高效、优质解决方案的响应能力，有助于进一步夯实技术护城河并持续提升品牌效应。

(3) 扩大产品供应能力，提升规模效益

近年来，公司已成功实现微波器件、光传感器、光模块等应用领域微纳系统封装管壳产品的试制与小规模供货，产品已通过严苛的合格供方认证，并已成功进入上述产品应用领域核心客户配套体系，业务规模高速增长，下游客户对微纳系统封装管壳产品的规模化采购需求正在加速释放。然而，公司现有产线产能已逐渐无法满足客户日益提升的订单需求，若公司产能建设滞后，可能导致市场份额被侵蚀，存在优质订单、核心客户流失的风险，进而对公司的业务拓展造成不利影响。

本项目拟通过引进推板炉、流延线、镀膜机等核心生产设备，结合公司自主研发的工艺技术，建设智能化、规模化的生产线，从而实现单批次投料量与产出效率的有效提升，显著降低单位产品的固定成本分摊与物料损耗。同时，配套的 MES 系统将确保生产过程的高效流转与质量的全程可追溯，进一步提升产品质量的一致性与成本控制能力，为持续扩大市场份额奠定坚实的产能基础。

3、项目实施的可行性分析

(1) 深厚的技术积累与持续的自主创新能力支撑项目实施

公司作为国家高新技术企业，深耕微纳系统封装管壳领域多年，取得了“一种 3D 堆叠形式的陶瓷封装管壳”、“一种陶瓷金属封装外壳、制备方法及其应用”等多项相关发明专利，并已建成覆盖从设计仿真到微组装应用的全流程技术平台。在设计技术方面，掌握了先进的结构设计、高频高速信号传输和热力学设计仿真技术，能够针对用户的需求设计出符合传输性能和机械性能的陶瓷管壳和电路基板，拥有完整的设计、加工、性能测试、可靠性评估能力；在原材料制备方面，具备先进的陶瓷原料制备技术和陶瓷材料匹配的金属浆料配方体系，能够为多层陶瓷产品提供高强度、高导热、高性能、低成本的原材料；在制造技术方面，掌握了多层陶瓷管壳和基板的制造技术，包括流延、冲孔冲腔、金属化印刷、层压、热切、烧结、钎焊等技术，能够根据产品特定的使用环境，向用户提供高密度、高精度、高性能、高可靠、体积小、重量轻的陶瓷管壳和电路基板。同时，现阶段公司已成功实现多款产品从研发、试制到小批量交付，在核心技术路线、生产工艺实现等方面均具有较高成熟度，项目

将结合公司在产品设计、原材料制备、制造工艺等关键技术领域的长期积累以及方案落地能力，能够保障项目投产后生产效率与产品质量，项目具备较高的可实现性。

（2）需求侧牵引为项目实施提供市场环境支撑

近年来，物联网、新能源汽车等行业稳步发展，叠加商用航空航天、低空经济、天地一体化信息网络、人工智能数据中心高速光模块等新兴场景加速落地，成为微波器件、光传感、光模块等行业发展的重要驱动力，继而带动高可靠、高性能 HTCC 产品的需求呈高速增长。以光模块领域为例，根据 Frost & Sullivan 数据，随着 800G、1.6T 光模块引领中国光模块行业进入新一轮产品与技术升级周期，预计 2030 年中国光模块市场规模将增长至 985.47 亿元，2025 至 2030 年复合增长率 17.04%。QYResearch 数据显示，光通信封装是现阶段 HTCC 产品第一大市场，占有大约 26.07% 的市场份额，其次为航空、工业领域和消费电子等领域，多赛道需求有望同步高速增长。

经过持续的市场培育与产品验证，公司已经积累了一批合作稳固的优质客户群体，并形成较强的业务黏性。公司微纳系统封装管壳产品已通过严苛的合格供方认证，成功进入微波器件、光传感器、光模块等产品应用领域客户配套体系，并均处于从小批量供货推进至大规模供货的合作阶段。

广阔的下游市场以及现有客户的存量迭代与增量型号需求，将为本项目新增产能的顺利消纳提供了明确的支撑；而头部客户授予的合格供方资质，则构成了向新客户群体拓展的信任基础。同时下游客户在合作过程中持续提出的前沿需求，将不断引导公司开展适应性与前瞻性技术开发，使得产品迭代方向与市场需求保持紧密同步。上述源于需求侧的牵引与资质支撑，从多个环节降低了项目产能释放的不确定性，为后续市场开拓奠定了相对稳固的基础。

（3）成熟的核心团队与产品管理体系保障项目高效落地

公司已建成一支经验丰富、结构稳定的核心技术团队，主要成员深耕微纳系统封装管壳产品领域多年，在产品设计、原材料制备、产品制造等方面具备深厚的产业认知与项目管理经验，能够有效统筹研发、生产、市场等全链条资源。

在此基础上，公司依托一体化的设计、材料、工艺技术体系，可根据客户多样化需求实施多品种、差异化生产，并且可自主完成从结构研发、材料选型、精密加工、气密封装、性能检测等全流程关键工序，在供应链安全与生产自主性方面具备显著优势，公司相关管理模式及技术能力可直接赋能本次项目建设。此外，公司已通过 ISO9001、IATF16949 等质量管理体系认证，建立了覆盖设计开发、原材料采购、生产及售后的全过程质量管控体系，可确保研发成果高效转化为批量交付的合格产品，为项目的顺利实施与稳定运营提供坚实的管理体系支持。完备的产品管理体系为本项目快速投产、满足下游多领域客户规模化交付需求提供了坚实保障。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为鸿安信，拟投资总额 15,616.75 万元，其中拟使用募集资金投入 14,089.43 万元。本项目投资概算列示如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	总投资额	拟使用募集资金	募集资金投入占比
1	工程建设费用	12,150.51	12,089.43	85.80%
1.1	建筑工程	683.00	683.00	4.85%
1.2	设备购置及安装	11,467.51	11,406.43	80.96%
2	研发费用	2,172.79	2,000.00	14.20%
3	建筑租赁	459.70		
4	预备费	364.52		
5	铺底流动资金	469.23		
合计		15,616.75	14,089.43	100.00%

5、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目建设内容主要包括场地租赁及装修、设备购置及安装、人员招聘与培训、研发课题开展及试运行，整体建设期为 2 年。计划实施进度表如下：

阶段/时间	T+1		T+2	
	H1	H2	H1	H2
项目前期准备				
装修装饰设计				
装修施工				

阶段/时间	T+1		T+2	
	H1	H2	H1	H2
软硬件采购、安装及调试				
人员招聘与培训				
研发课题开展				
试运行				

6、项目审批备案情况

本项目实施地点位于安徽六安市舒城县杭埠镇舒城电子信息产业园等地，拟采用租赁厂房的方式实施。项目已取得舒城县政务服务管理局经济开发区分局出具的《舒城县政务服务管理局经济开发区分局备案表》（项目代码：2606-341523-04-02-497367）；环评手续尚在办理中，公司将根据相关法律法规要求，积极推进相关手续的办理，确保项目后续建设的合规性。

7、项目经济效益情况

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入。

（三）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟将募集资金中的 3,539.42 万元用于补充流动资金，以满足公司日常运营资金需求，促进公司主营业务的持续健康发展，提升公司整体盈利能力。

2、补充流动资金的必要性和可行性

（1）满足公司业务发展对流动资金的需求

随着公司业务规模的持续扩张，生产经营所需的原材料采购成本、人力成本等支出将不断增加，需要大量投入流动资金。基于下游市场需求，预计未来公司仍将处于业务及产品线拓展阶段，研发投入、日常经营、新产品扩产等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。通过补充流动资金，有助于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展。

（2）优化公司资本结构，提高抗风险能力

截至 2025 年 12 月 31 日，公司短期借款、1 年内到期的非流动负债及长期借款余额为 27,140.19 万元。本次发行通过补充流动资金，有利于公司优化资本结构和改善财务状况，提高公司抗风险能力。

（3）提高公司资金使用效率，降低财务成本

公司通过本次发行股票募集资金 3,539.42 万元用于补充流动资金，有利于公司保持稳健的财务结构，充实日常经营所需流动资金，提升公司财务支付能力，提高公司整体资金使用效率，降低财务成本，有利于公司长期稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

三、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金不超过 30,000.00 万元（含本数），用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目、补充流动资金。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于公司业务转型升级，拓展新的业务增长点，提升公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的顺利实施，将有效促进公司的可持续发展。公司本次拟实施的募投项目结合了市场需求和未来发展趋势，有利于提高公司整体竞争实力和抗风险能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有所提高，资本实力得到增强，资本结构得到进一步的改善。由于募集资金投资项目建设需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降。但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，从而增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展，为股东贡献回报。

四、可行性分析结论

综上所述，公司本次发行募集资金投向符合国家政策方向、行业发展趋势

及公司战略需求，募集资金的使用将会为公司带来良好的收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司资金规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2026年8月6日